

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	Capacitance value/ Kapazitätswert:
24-007473	3	Gold flash over nickel <i>Gold über Nickel</i>	370 pF ± 20 %
24-007472	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel <i>20 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	
24-007471	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel <i>30 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	
24-007483	3	Gold flash over nickel <i>Gold über Nickel</i>	830 pF ± 20 %
24-007482	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel <i>20 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	
24-007481	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel <i>30 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	
24-007493	3	Gold flash over nickel <i>Gold über Nickel</i>	1300 pF ± 20 %
24-007492	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel <i>20 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	
24-007491	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel <i>30 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	

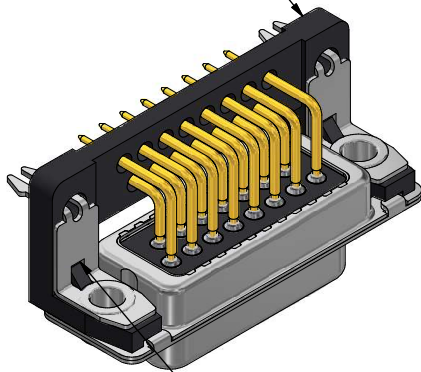
**Technical specification/
Technische Daten:**

Working voltage/ Betriebsspannung:	100 VDC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	5 A
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 1 GΩ
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit (DWV):	424 VDC
Temperature working range/ Umgebungstemperatur:	- 25 °C ... + 105 °C
Capacitance value/ Kapazitätswert:	see Table/ siehe Tabelle
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3



Riveted insert/
Hohlrinne

Mounting bracket with fixing plate/
Befestigungswinkel mit Zentrierplatte



Grounding bracket with snap/
Erdungswinkel mit Clip

**Materials/
Werkstoffe:**

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni Contact tails pretinned/ Kontaktspitzen verzinkt
Insulator/ Isolierkörper:	High temp. PA UL 94 V-0
Shells/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Riveted insert/ Hohlrinne:	Cu alloy, Sn over Ni
Mounting bracket with fixing plate/ Befestigungswinkel mit Zentrierplatte:	High temp. PA UL 94 V-0
Grounding bracket with snap/ Erdungswinkel mit Clip:	Cu alloy, Sn

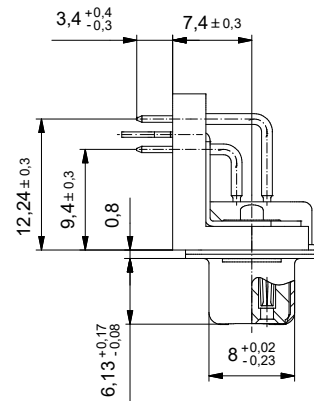
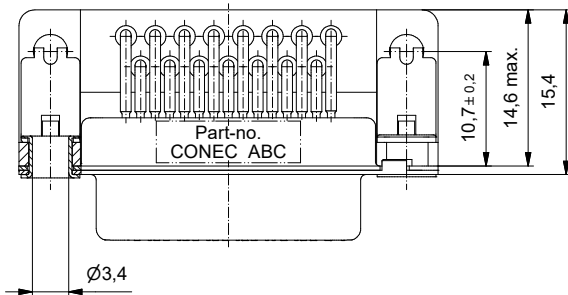
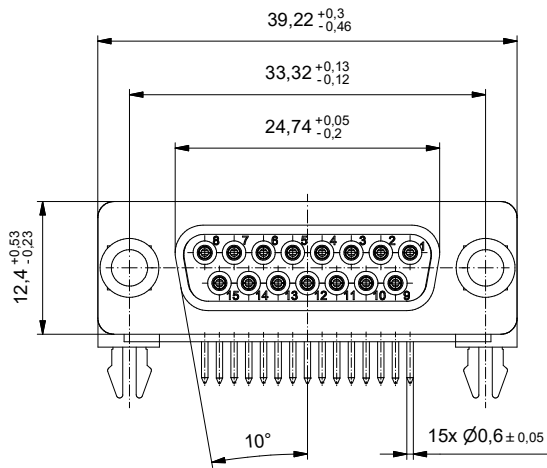
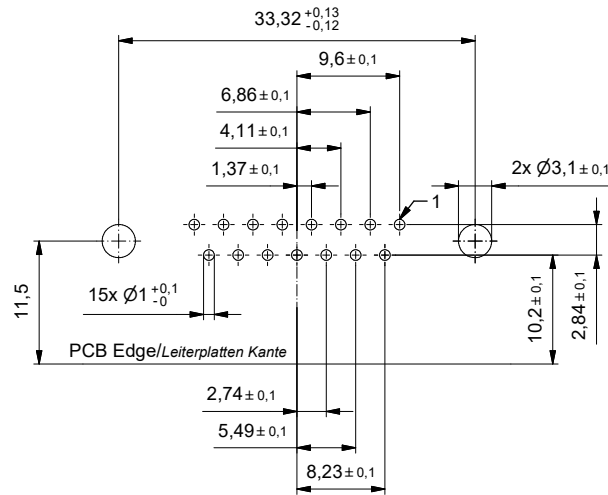
**Installation specification/
Montagedaten:**

Solder parameter/ Lötparameter:	
Solder preheat temperature/ Vorheiztemperatur:	100 °C for 30 sec./ 100 °C für 30 Sek.
Solder bath temperature/ Lötbadtemperatur:	260 °C for 5 sec./ 260 °C für 5 Sek.
PCB hole drillings/ Leiterplattenbohrbild:	see sheet 2/ siehe Seite 2
PCB snap for hole diameter/ PCB Clip für Lochdurchmesser:	Ø3,1 mm
Circuit board thickness/ Leiterplattenstärke:	1,6 mm

		dim. in mm		D-SUB C-Filter Female 15pos. Solder pin angled with riveted insert, mounting bracket and grounding bracket with snap	
		Date/Datum	Name	D-SUB C-Filter Buchse 15pol. Lötstift abgewinkelt mit Hohlrinne, Befestigungswinkel und Erdungswinkel mit Clip	
		drawn/ ges.	21.09.2022	J.Brandt	
		appd./ gepr.	11.10.2022	H.Schmidt	
Index: a Original	Scale/ Maßstab:	2:1		dwg no / Z.-nr.:	24K1A2379
RoHS compliant/ konform				DIN- A3	1 / 2

The reproduction, distribution and sale of this document as well as the communication of its content to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. We reserve the right to withdraw advertising and/or to discontinue the supply of goods without notice. Die Vervielfältigung, Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der CONEC AG.

PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)



Index: a Original	Scale/Maßstab: 2:1		dim. in mm	D-SUB C-Filter Female 15pos. Solder pin angled with riveted insert, mounting bracket and grounding bracket with snap D-SUB C-Filter Buchse 15pol. Lötstift abgewinkelt mit Hohlriete, Befestigungswinkel und Erdungswinkel mit Clip	dwg no / Z.-nr.: 24K1A2379	DIN- A3	
			Date/Datum				Name
			drawn/ ges.				21.09.2022
RoHS compliant/konform			appd./ gepr.	11.10.2022	H.Schmidt	2 / 2	

The reproduction, distribution and sale of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Otherwise will be held liable for the payment of damages.
 Die Vervielfältigung, Verbreitung, auch auszugsweise, sowie das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Schaeffler AG.
 The reproduction, distribution and sale of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Otherwise will be held liable for the payment of damages.
 Die Vervielfältigung, Verbreitung, auch auszugsweise, sowie das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Schaeffler AG.